

(12) 特許協力条約に基づいて公開された国際出願

(19) 世界知的所有権機関
国際事務局

(43) 国際公開日
2013 年 12 月 5 日(05.12.2013)



(10) 国際公開番号
WO 2013/179943 A1

- (51) 国際特許分類:
C09J 7/02 (2006.01) C09J 179/08 (2006.01)
C09J 11/04 (2006.01) H01L 21/60 (2006.01)
C09J 11/06 (2006.01) H01L 23/29 (2006.01)
C09J 163/00 (2006.01) H01L 23/31 (2006.01)
- (21) 国際出願番号: PCT/JP2013/064036
- (22) 国際出願日: 2013 年 5 月 21 日(21.05.2013)
- (25) 国際出願の言語: 日本語
- (26) 国際公開の言語: 日本語
- (30) 優先権データ:
特願 2012-123146 2012 年 5 月 30 日(30.05.2012) JP
- (71) 出願人: 東レ株式会社(TORAY INDUSTRIES, INC.)
[JP/JP]; 〒1038666 東京都中央区日本橋室町 2 丁
目 1 番 1 号 Tokyo (JP).
- (72) 発明者: 松村 和行(MATSUMURA, Kazuyuki); 〒
5208558 滋賀県大津市園山 1 丁目 1 番 1 号 東

レ株式会社 滋賀事業場内 Shiga (JP). 藤丸浩一
(FUJIMARU, Koichi); 〒5208558 滋賀県大津市園山
1 丁目 1 番 1 号 東レ株式会社 滋賀事業場内
Shiga (JP). 野中 敏 央(NONAKA, Toshihisa); 〒
5208558 滋賀県大津市園山 1 丁目 1 番 1 号 東
レ株式会社 滋賀事業場内 Shiga (JP).

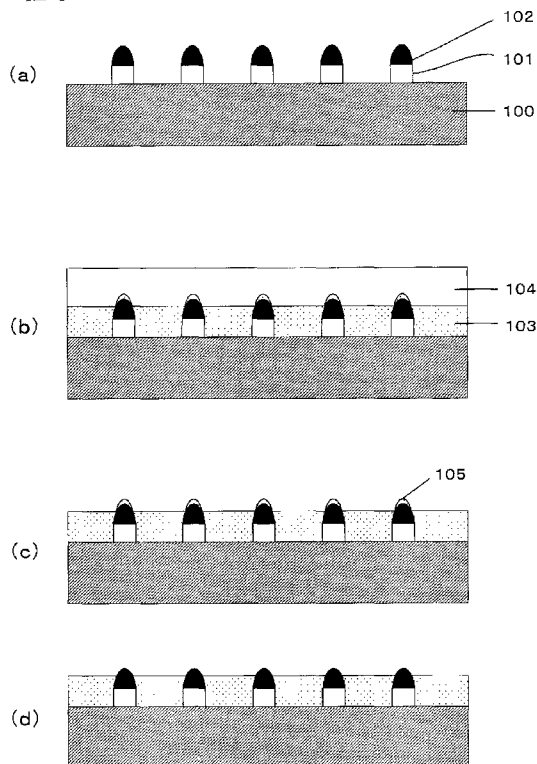
- (81) 指定国 (表示のない限り、全ての種類の国内保
護が可能): AE, AG, AL, AM, AO, AT, AU, AZ, BA,
BB, BG, BH, BN, BR, BW, BY, BZ, CA, CH, CL, CN,
CO, CR, CU, CZ, DE, DK, DM, DO, DZ, EC, EE, EG, ES,
FI, GB, GD, GE, GH, GM, GT, HN, HR, HU, ID, IL, IN,
IS, JP, KE, KG, KM, KN, KP, KR, KZ, LA, LC, LK, LR,
LS, LT, LU, LY, MA, MD, ME, MG, MK, MN, MW, MX,
MY, MZ, NA, NG, NI, NO, NZ, OM, PA, PE, PG, PH,
PL, PT, QA, RO, RS, RU, RW, SC, SD, SE, SG, SK, SL,
SM, ST, SV, SY, TH, TJ, TM, TN, TR, TT, TZ, UA, UG,
US, UZ, VC, VN, ZA, ZM, ZW.
- (84) 指定国 (表示のない限り、全ての種類の広域保
護が可能): ARIPO (BW, GH, GM, KE, LR, LS, MW,

[続葉有]

(54) Title: ADHESIVE SHEET FOR PRODUCTION OF SEMICONDUCTOR DEVICE HAVING BUMP ELECTRODES AND PRODUCTION METHOD FOR SEMICONDUCTOR DEVICE

(54) 発明の名称: バンプ電極付き半導体装置製造用接着剤シートおよび半導体装置の製造方法

【図1】



(57) Abstract: Bump electrodes can be exposed without damaging the bump electrodes, by using an adhesive sheet for use in the production of a semiconductor device having the bump electrodes, said sheet having an alkali-soluble adhesive film formed upon a soft film. In addition, as a result of subsequently using an alkali aqueous solution and wet etching an adhesive on the bump tops, a state whereby no adhesive is present on the bump tops can be achieved and a semiconductor device having excellent connection reliability after flip chip mounting can be produced.

(57) 要約: 軟質フィルム上にアルカリ可溶性接着剤フィルムが形成されたバンプ電極付き半導体装置製造用接着剤シートにより、バンプ電極に損傷を与えることなくバンプ電極が露出可能であり、さらにその後、アルカリ水溶液を用いてバンプトップ上の接着剤をウェットエッチングすることにより、バンプトップ上に接着剤が存在しない状態にすることができ、フリップチップ実装後に接続信頼性の優れる半導体装置を製造することが可能になる。



MZ, NA, RW, SD, SL, SZ, TZ, UG, ZM, ZW), ユーラ
シア (AM, AZ, BY, KG, KZ, RU, TJ, TM), ヨーロッ
パ (AL, AT, BE, BG, CH, CY, CZ, DE, DK, EE, ES, FI,
FR, GB, GR, HR, HU, IE, IS, IT, LT, LU, LV, MC, MK,
MT, NL, NO, PL, PT, RO, RS, SE, SI, SK, SM, TR),

OAPI (BF, BJ, CF, CG, CI, CM, GA, GN, GQ, GW, ML,
MR, NE, SN, TD, TG).

添付公開書類:

— 国際調査報告 (条約第 21 条(3))